

龍華科技大學115學年度教師產業研習 半導體技術研習課程（梯次一）

課程簡介

本研習課程共規劃4個課程單元，分別為「半導體產業局勢分析與環境永續趨勢」、「半導體元件製程實作」、「半導體封裝測試實作」與「企業參訪」，希望透過研習課程，讓參與研習教師，對於半導體技術能有更全面進一步地瞭解。

課程時間

115/6/6(六)、6/7(日)、6/13(六)、6/14(日)
115/6/20(六)、6/22(一)~6/26(五) 共計10天

研習地點

龍華科技大學(桃園市龜山區萬壽路一段300號)

研習人數

名額有限，請儘早報名(本校教師最多10位)

研習對象

歡迎技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員
教師或有興趣教師均可報名
(若全程出席將可獲得計10天，共60小時研習證書)

報名資訊

即日起至115年6月5日中午12:00為止

報名網址:<https://forms.gle/VoiUtTFkWqDqfMFi9>



報名QRcode

聯絡資訊

聯絡窗口：0905-617506 卓助教
電子信箱：leoatlu@gmail.com

115學年度半導體技術研習課程及時間表

日期	時間	課程
115.6.6 (六)	09:00-12:00	全球半導體先進製程趨勢與國際關係
	13:00-16:00	全球半導體產業分析
115.6.7 (日)	09:00-12:00	ESG永續發展簡介
	13:00-16:00	半導體產業淨零碳排及污染改善之ESG永續推動趨勢
115.6.13 (六)	09:00-12:00	半導體基礎入門
	13:00-16:00	半導體真空介紹
115.6.14 (日)	09:00-12:00	半導體製程介紹 (高溫、電漿應用製程)
	13:00-16:00	半導體製程介紹 (黃光及其他製程、廠務)
115.6.20 (六)	09:00-12:00	半導體製程實作(黃光製程)
	13:00-16:00	半導體製程實作 (薄膜成長、高溫氧化製程)
115.6.22 (一)	09:00-12:00	半導體封裝介紹(切割製程)
	13:00-16:00	半導體封裝介紹(功率元件封裝簡介)
115.6.23 (二)	09:00-12:00	半導體先進封裝
	13:00-16:00	半導體封裝實作 (固晶、導線架、迴焊製程)
115.6.24 (三)	09:00-12:00	半導體測試介紹 (半導體元件測試介紹)
	13:00-16:00	半導體測試介紹 (高頻半導體元件測試)
115.6.25 (四)	09:00-12:00	半導體測試實作 (電性、外觀檢測製程)
	13:00-16:00	半導體測試實作(測試分析實務)
115.6.26 (五)	09:00-16:00	企業實習